

近日，北京弘光向尚科技有限公司（以下简称“弘光向尚”）获得元航资本数千万人民币的天使轮融资。

弘光向尚公司成立于2020年1月，是一家专业从事新一代集成电路硅基光电集成芯片设计的高科技企业。目前已经完成工程化流片的产品是400GbpsDR4和FR4系列硅基光电集成传输芯片系列产品和相干光产品。核心硅光芯片产品基于绝缘衬底硅（SOI）平台，兼容互补金属氧化物半导体（CMOS）微电子制备工艺制造，具备CMOS技术超大规模逻辑、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势，可广泛用于我国的新一代5G、6G通信、数据中心、光纤接入、消费电子、自动驾驶、工业自动化等领域。

公司核心技术团队在集成微波器件（MMIC）、光波器件和系统设计领域以及工艺方面积累了丰富的实践经验。作为一家专注于硅光收发芯片的设计（Fabless）企业，弘光向尚公司已经具备了开发平面光波导工艺和集成光无源器件设计和生产经验，掌握了MMI、DC、Mux/demux、边缘耦合器等光无源器件的集成设计和关键的生产工艺。

公司目前推出的产品具有全部自有知识产权，为我国的新一代5G、6G光通信传输，大型云计算中心互联通信提供了关键部件。

弘光向尚创始人方旭升表示：“公司的创始团队有光、电芯片领域国际化顶级专家，有集成电路行业运营经验丰富的高端人才，公司掌握硅光芯片设计和量产环节的全套核心技术，确保产品在产能、成本、良率和稳定性上的优势。首期产品达到国际先进水平，具有明显的竞争优势；同时，公司的产品通过多次流片，与全球顶级硅光Foundry建立了密切合作关系，并建立了流片、封测环节完备的供应链，将为产品实现规模化量产、提升良率提供关键保障。公司将结合自身优势，加快推出硅基光电高端芯片系列产品，填补中国国内空白，解决‘卡脖子’现状。”

元航资本合伙人王新河表示：“硅基光电器件和芯片是半导体技术发展的一个极具发展前景的新领域，是一项革命性的技术。与第三代、第四代半导体一样，具有目前硅基微电子半导体芯片无法替代的特点和应用优势，未来几年内势必成为半导体行业的重要性产品分支和方向。是构成半导体芯片的产业的重要支柱之一。我们认为，在光通信应用领域，硅光集成芯片技术是最有可能在未来3到5年内全面替代目前在5G通信，数据中心采用的光模块的换代性产品，是最有希望快速形成数百亿级市场的产品。目前，硅光集成电路技术和产品在国际上的发展也仅仅5年左右，我国在200Gbps/400Gbps产品化方面才刚刚起步。”附